



**Wissenschaftliches Kolloquium des
Instituts für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik
und des
Zentrums für mikrotechnische Produktion**

In Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Arbeitskreis Elektronik-Technologie:

46. Treffen des Arbeitskreises

**Hochauflösende geometrische Charakterisierung
im Electronic Packaging**

Datum: 07. Dezember 2005

Ort: TU Dresden, Barkhausen-Bau
Hörsaal 106

Agenda:

- 09:30 Uhr Eröffnung der Veranstaltung
*Hr. Prof. Dr.-Ing. habil. K.-J. Wolter – TU Dresden, IAVT
Hr. Prof. Dr.-Ing. R. Bauer – HTW Dresden*
- 09:50 Uhr Aufgaben, Verfahren und Lösungsmöglichkeiten zur
hochauflösenden geometrischen Charakterisierung
elektronischer Bauelemente und Baugruppen
Hr. Prof. Dr.-Ing. habil. K.-J. Wolter – TU Dresden, IAVT
- 10:30 Uhr Dimensionelles Messen in der Aufbau- und Verbindungstechnik
mit Scanningprofilometer und Konfokalmikroskop
Hr. Dr. R. Brodmann – NanoFocus AG, Oberhausen
- 11:15 Uhr Optische Leckmessung auf Wafer-Level für die Produktion von
hermetisch verkapselten MEMS-Bauelementen
Hr. F. Müller – Hymite GmbH, Berlin
- 11:45 Uhr *Mittagspause*

- 12:45 Uhr Oberflächenvermessung mit dem TherMoiré-Verfahren
Hr. Dr. H. Wohlrabe – TU Dresden, ZμP
- 13:15 Uhr Optische Geometriemessung im Electronic Packaging
Hr. W. Fröhlich - Mahr Multisensor GmbH, Waldgassen
- 13:45 Uhr Kaffeepause
- 14:15 Uhr Laborbesichtigung und Gerätevorführungen zur geometrischen
Oberflächencharakterisierung (*siehe auch Informationen unten*)
- gegen*
16:30 Uhr *Ende der Veranstaltung*

Information zu Maschinenvorführungen und Testmessungen

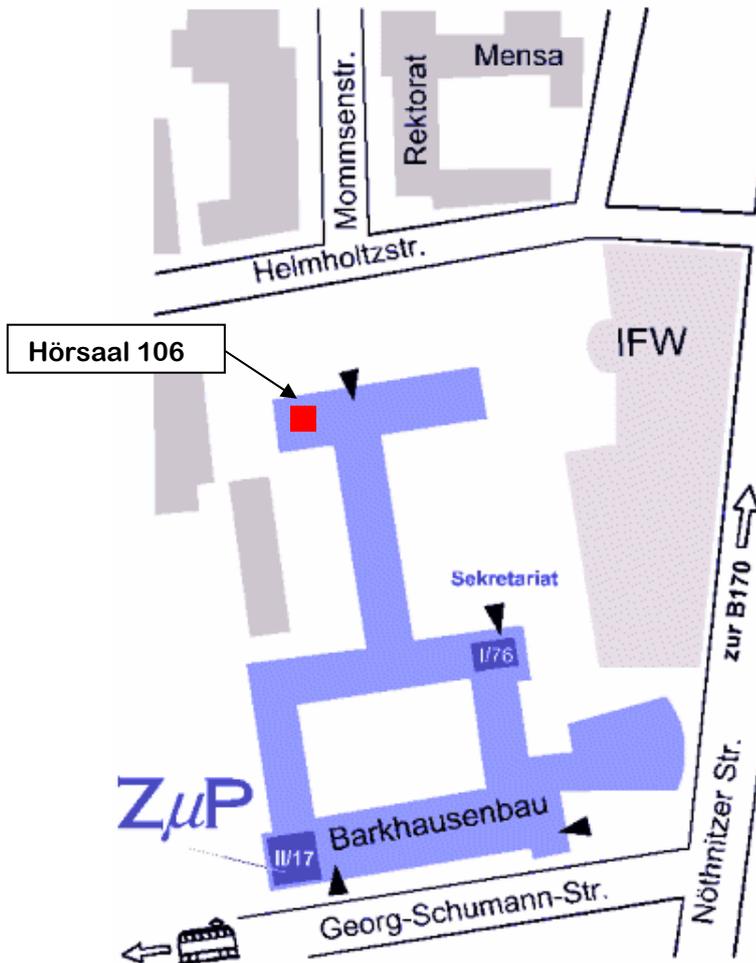
Im Rahmen der Laborbesichtigung werden verschiedenen Messsysteme zur geometrischen Charakterisierung von Oberflächen vorgeführt werden. Dazu ist es möglich, dass Sie, unsere Gäste, in begrenztem Umfang Proben aus Ihrer Praxis zur Vermessung mitbringen (z.B. Leiterplatten, strukturierte Wafer, CSPs). Wir bieten dazu Messungen an folgenden Systemen an (bitte Limitierungen bei den Probengrößen beachten):

- Konfokalmikroskop **μsurf®** (Fa. NanoFocus):
max. Probengröße 100 x 100mm², 1mm in Z-Richtung
- Scanningprofilometer **μscan®** (Fa. NanoFocus):
max. Probengröße 100 x 200mm², 1mm in Z-Richtung
- 3D-Koordinatenmessgerät **PMC 500** (Fa. Mahr Multisensor GmbH):
max. Probengröße 500 x 600 x 200mm³
- TherMoiré-Messgerät **PS 88** (Fa. AkroMetrix):
plane, diffus reflektierende Objekte (z.B. unbestückte Leiterplatten, großflächige Bauelemente) bis max. 200 x 200mm².

Eine vorherige Anmeldung für die Nutzung dieses Angebotes ist zwingend notwendig. Bitte schicken Sie dazu eine Email an:

oppermann@zmp.et.tu-dresden.de

Veranstaltungsort



TU Dresden
Barkhausen-Bau Erdgeschoss
Hörsaal 106

Helmholtzstraße 18
01069 Dresden

Alle Interessenten sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Um eine rechtzeitige Teilnahmemeldung wird gebeten. Kontaktaufnahme bitte an Herrn Prof. R. Bauer (bauer@et.htw-dresden.de, Tel.: 0351/462 3605, Fax: 0351/462 2175) oder an Herrn Dr. M. Oppermann (oppermann@zmp.et.tu-dresden.de, Tel.: 0351/463 35051, Fax: 0351/463 37069).